

THINKSTATION E30

エントリー・ワークステーション

ビジネスユースに耐える信頼性と優れた生産性を備え、充実のパフォーマンスと優れた初期導入コストを実現。最新技術の導入で長期のライフサイクルを獲得したエントリー・ワークステーション ThinkStation E30。

高度なビジネスの最前線に欠かせないワークステーションに求められる基準は、卓越したパフォーマンスと優れた信頼性。中でも、マシンパワーを必要とするデジタルコンテンツ制作業務やCAD設計業務、ファイナンシャル業務などには、ビジネスに最適化された信頼のおけるマシンを選択することが業務効率の向上には欠かせません。ThinkStation E30は、優れた初期導入コストを実現しつつも、最先端の技術を惜しみなく投入し長期のライフサイクルを実現。優れたユーザビリティと機能性を高いレベルで融合した、エントリーレベルのワークステーション。企業の厳しい選択基準に応える高性能を確保し、社会の求める環境性能を余裕でクリア。ビジネスのプロフェッショナルに応える1台です。



新世代テクノロジーが凝縮されたCPUで高性能を実現

ThinkStation E30の心臓部であるプロセッサーは、最新のインテル®マイクロアーキテクチャー(Sandy Bridge*)で設計されたインテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリーか第2世代インテル® Core™ i3 プロセッサーから選択可能。先端の32nmのプロセス技術で生産されたプロセッサーを搭載することにより、圧倒的な処理能力と省電力性を両立。最大8GBの大容量キャッシュを搭載し、ワークステーションに求められる高度なコンピューティングと信頼性を確保し、快適な作業環境を実現します。

*開発コード名

並列処理で高速化を実現する最先端テクノロジー

処理能力に余裕のあるコアのリソースを活用し、並行処理によって効率的にデータ処理する技術がインテル® ハイパースレッディング・テクノロジー。[†] 対応する高度にスレッド化されたアプリケーションでは、4コアを持つインテル® Xeon® E3-1200 ファミリー搭載機なら、最大8スレッドを同時に並行処理することにより複数のタスクを効率的に処理することができます。

高負荷時の演算回数を増やし高速処理を実現

搭載されている新しいプロセッサーは、起動時や高負荷時の一定の条件を満たした場合に、各コアの定格クロック速度を一時的に高めて処理速度を大幅に高速化するインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0[‡]を採用。定格クロック速度をTDPの限度以上まで一時に高めて処理速度を高速化。負荷に応じて柔軟なクロック速度を利用することで、システムパフォーマンスを高めます。

最大32GB*の高い信頼性のECCメモリー搭載可能

データのエラーと発生箇所を検出しエラー修正の機能を持つ、高い信頼性のECCメモリーをサポート。アクセス速度の速いDDR3-1333のDIMMを4スロットに最大32GB*まで搭載可能で、障害の予防にも効果的。高画質動画や大容量データ処理時にも高い作業効率を実現します。

*製品発表時の最大メモリー容量は16GBです。2011年秋リリース予定の8GB DIMMにて最大32GBをサポート致します。

作業を効率化する高速HDDとSSDをサポート

ミニタワーの筐体には、データストレージを2スロット装備。ストレージにはHDDに加え、データアクセスを大幅に高速化し、省エネルギー性に優れるSSDに対応(80GB・160GB)。大容量データにアクセスが多い業務にも快適で作業性に優れる信頼性の高いシステム構築が可能です。

データの安全性を高めるRAID対応

ThinkStation E30には、重要なデータ保存に欠かせないRAIDシステムにも対応。物理的な障害のリスクを低減し、データの2重化によるシステム障害への安全性を高め、冗長性を確保することができます。標準でRAID0と1に対応可能で、安全性の高いシステム運用を実現します。

インテル® AMT対応

インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーに対応。ハードウェア上に実装したOSに依存しないリモートからの運用管理機能を搭載。遠隔地からモニタリングやパッチの適用、ブルースクリーンからの起動、電源管理などデスクサイドサポートの手間を低減し、TCOの削減と運用管理業務の大幅な効率化に貢献します。

デジタルコンテンツ制作

パワフルな処理能力が生産性の向上を実現

ThinkStation E30は、最新テクノロジーの採用により、システムパフォーマンスを大幅に向上。最大約25%処理速度を向上し、グラフィック高速処理を実現。また、最大32GB*のECCメモリー対応で大容量データの作業効率を向上。アプリケーションの処理速度も高め快適な作業を実現します。

*製品発表時の最大メモリー容量は16GBです。2011年秋リリース予定の8GB DIMMにて最大32GBをサポート致します。

CADユーザー

ロスタイルムの減少で快適な作業が可能に

最新のプロセッサーは、グラフィック能力を大幅に向上。特に、レンダリングや描画速度の向上にインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0[‡]が効果を發揮。ロスタイルムを減少します。また、AutoCADなど、代表的なCADソフトベンダーによるISV認定を取得済で、導入後すぐに安心して使えることも大きなメリットです。

インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー

高性能スマート

ファイナンス業務

高い信頼性と高度な処理能力を確保

ThinkStation E30は、少しのミスも許されないファイナンシャル業務に最適な高い信頼性を確保。標準でサポートするRAID構成やECCメモリーの採用。さらに、セキュリティ性に配慮された多重のパスワード設定など、充実したシステムでセキュアな環境を構築可能。業務に欠かせない最大5画面のマルチディスプレイにも対応します。

BIMソリューション

高いパフォーマンスで、作業速度が大幅に向上

BIMソリューションの導入がすすむ建築設計業務で真価を発揮。インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー、NVIDIA® の高性能グラフィックボードにより、大容量メモリーを利用して快適でスムーズな設計作業が可能です。